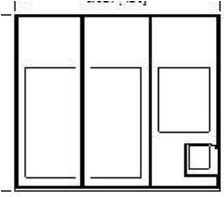
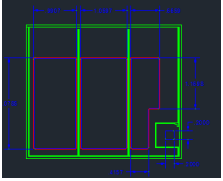




	Before Change Description	After Change Description
Lead Frame	Bare Cu gate finish, Etched type	Ag plated gate finish, Stamped type
Bond Wire	No Wire	BW, Cu,2.0 MIL
Fab Site	Pactech, Malaysia	Bucheon, Korea
Die Solderable Top Metal(STM)	Both Gate and Source pads have TiNiAg STM 	Only source pad has TiNiAg STM. Gate pad has no TiNiAg STM for Cu wire bonding purposes 

There is no product marking change as a result of this change.

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: FDMS86181

RMS : F57563

PACKAGE : PQFN8 CLIP SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/320
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgs	1008 hrs	0/320
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs	0/320
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-	0/960
IOL	MIL-STD-750 (M1037), AEC-Q101	Ta=25°C, delta Tj=100°C, on/off = 2 min	15000 cycs	0/320
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycs	0/320
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, biased	192 hrs	0/320
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/320
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs	0/90

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FDMS10C4D2N	FDMS86181
FDMS7556S	N/A
FDMS7558S	N/A
FDMS7560S	N/A
FDMS7570S	N/A
FDMS7572S	N/A
FDMS7650	N/A
FDMS8320L	N/A
FDMS8558S	N/A
FDMS8560S	N/A
FDMS86181	N/A

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



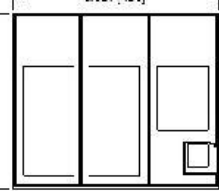
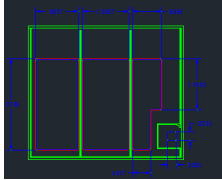
最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22650X

発行日: 16 Mar 2020

変更件名:	PQFN 56CLP において 銅ゲート・ワイヤー付きメタル・クリップへの変更とウェハー製造拠点の移管												
初回出荷予定日:	23 Jun 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。												
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Michelle.Lyn.Alaba@onsemi.com にお問い合わせください。												
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.Samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。												
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または KarenMae.Taping@onsemi.co にお問い合わせください。												
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てにお願いします。												
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます (DM21KK)。												
変更カテゴリ:	ウェハファブの変更, アセンブリの変更												
変更サブカテゴリ:	製造プロセスの変更, 材料の変更												
影響を受ける拠点:													
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:												
ON Semiconductor Bucheon, Korea	無し												
ON Semiconductor Cebu, Philippines													
説明および目的:	PQFN 56CLP において、ゲートのリードポストの接続性向上のため、プリモールド・クリップから 銅ゲート・ワイヤー付きメタル・クリップへ変更。												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Current:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Proposed</p> </div> </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CURRENT</th> <th>PROPOSED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clip Design</td> <td>Pre-molded</td> <td>Metal</td> </tr> <tr> <td>Gate connection</td> <td>Pre-Molded / No Wire</td> <td>Wire: Cu 2.0mil (SN:500807)</td> </tr> <tr> <td>Gate leadpost (LF)</td> <td>Bare Cu (SN:500811)</td> <td>Ag plated (SN:501354)</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CURRENT	PROPOSED	Clip Design	Pre-molded	Metal	Gate connection	Pre-Molded / No Wire	Wire: Cu 2.0mil (SN:500807)	Gate leadpost (LF)	Bare Cu (SN:500811)	Ag plated (SN:501354)
ITEM	CURRENT	PROPOSED											
Clip Design	Pre-molded	Metal											
Gate connection	Pre-Molded / No Wire	Wire: Cu 2.0mil (SN:500807)											
Gate leadpost (LF)	Bare Cu (SN:500811)	Ag plated (SN:501354)											
この変更は、組立工程における次の変更が伴います。													
1. プリモールド・クリップのフローにおける事前組立ステップの排除													
2. 組立工程の追加 (フラックス除去、ワイヤーボンド)													



	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Bare Cu gate finish, Etched type	Ag plated gate finish, Stamped type
ボンドワイヤー	No Wire	BW, Cu, 2.0 MIL
ウェハー製造拠点	Pactech, Malaysia	Bucheon, Korea
ダイのはんだ付け可能トップメタル (STM)	<p>ゲートとソースの両方のパッドに TiNiAg STM があります</p> 	<p>ソースのパッドにのみ TiNiAg STM があります。銅ワイヤーのボンディングのため、ゲートのパッドには TiNiAg STM がありません</p> 

今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。

信頼性データの要約:

デバイス名 : FDMS86181

RMS : F57563

パッケージ : PQFN8 CLIP SNGL HPBF

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/320
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgs	1008 hrs	0/320
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs	0/320
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-	0/960
IOL	MIL-STD-750 (M1037), AEC-Q101	Ta=25°C, delta Tj=100°C, on/off = 2 min	15000 cycs	0/320
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycs	0/320
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, biased	192 hrs	0/320
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/320
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C	10 secs	0/90

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22650X

発行日: 16 Mar 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDMS10C4D2N	FDMS86181
FDMS7556S	N/A
FDMS7558S	N/A
FDMS7560S	N/A
FDMS7570S	N/A
FDMS7572S	N/A
FDMS7650	N/A
FDMS8320L	N/A
FDMS8558S	N/A
FDMS8560S	N/A
FDMS86181	N/A